

2022年度 製造中核人材育成セミナー日程

1日目 (火)		(プロセス)		2日目 (水)		(プロセス)		3日目 (木)		(プロセス)		4日目 (金)		(プロセス)	
9:00				9	プロセス講義 (馬場)			9	プロセス講義 (馬場)			9	プロセス講義 (馬場)		
							37. p-ch S/Dフォトリソ (安藤・城戸)		休憩		43. RCA洗浄 (安藤・城戸)				52. 配線フォトリソ (安藤・城戸)
				10	実習生プロセス (佐藤) ・フォトリソ (2回目)			10	装置説明 (CR) (佐藤) ・RCA洗浄			10			
10:00							38. p-ch S/Dインプラ (安藤・城戸)		実習生プロセス ・RCA洗浄 (佐藤) ・拡散炉 (佐藤) ・PE-CVD (佐藤)		44. S/D活性化熱処理 (安藤・城戸)		実習生プロセス		53. AIエッチング (安藤・城戸)
	開始 10:30 御挨拶 (中村センター長)												・フォトリソ (4回目) (佐藤) ・MetalRIE工程 (佐藤) ・レジスト除去 (WET) (佐藤) ・AIシタリング (佐藤)		54. フォトレジスト除去 (安藤・城戸)
	オリエンテーション (馬場)		予備時間	11	デバイス講義 (馬場)		39. フォトレジスト除去 (安藤・城戸)		プロセス講義 (馬場)		45. 酸化膜堆積 (安藤・城戸)				55. シタリング (安藤・城戸)
	安全教育 (馬場)														
	クリーンルーム入室・見学 (馬場・佐藤)			12	昼食 Lunch		予備時間		昼食 Lunch		予備時間		昼食 Lunch		測定 (安藤)
12:00			予備時間												
				13	設計講義 (中村)		40.n-ch S/Dフォトリソ (安藤・城戸)		実習生プロセス (佐藤) ・PE-CVD ・フォトリソ (3回目) ・エッチング (2回目)		46. コンタクトフォトリソ (安藤・城戸)		周辺装置実習 ・ダイサー (佐藤) ・ワイヤーボンディング (佐藤)		・ウエハダイシング ダイシング (佐藤・城戸)
13:00	進捗状況説明・プロセス講義 (馬場)										47. 酸化膜エッチング (RIE)		測定実習説明 (中村) ・測定デバイス、結果予測など		測定 (安藤)
				14	個別装置実習 (佐藤) ・マスクレス露光装置		41. n-ch S/Dインプラ (安藤・城戸)		装置説明 (CR) (佐藤) ・スパッタリング		48. 酸化膜エッチング 49. フォトレジスト除去 (安藤・城戸)		休憩		
14:00	装置説明 (CR) (佐藤) ・フォトリソグラフィ 実習生プロセス (佐藤) ・フォトリソ (1回目)		34.ゲートフォトリソ (安藤・城戸)		休憩				実習生プロセス (佐藤) ・スパッタリング工程				測定実習 (中村) ・p-MOS、n-MOS、リングオシレー タなど測定		測定 (安藤)
				15	クリーンルームユーティリティ見学 (中村)				休憩						・譲渡CD-ROM作成 (城戸)
15:00	休憩														
	プロセス講義 (馬場)		35.Poly-Siエッチング 36.フォトレジスト除去 (安藤・城戸)				42. フォトレジスト除去 (安藤・城戸)		CMOS周辺装置実習： FIB-SEM (佐藤) ・FIB-SEMの紹介 ・既存CMOSチップの観察、FIB加工		50. HF洗浄 51. Al堆積 (安藤・城戸)		まとめ (中村センター長) 修了証授与 終了16:00		
16:00	装置説明 (CR) (佐藤) ・RIE装置 実習生プロセス (佐藤) ・エッチング ・フォトレジスト除去			16	プロセス講義 (馬場)				プロセス講義 (馬場)						
17:00	Q&A (自由参加：馬場)		予備時間	17	Q&A (自由参加：馬場)		予備時間		Q&A (自由参加：馬場)		予備時間				

座学など (講義室)
実習・見学 (CR、センター内施設)
昼食・休憩

注意：セミナーの進捗状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。